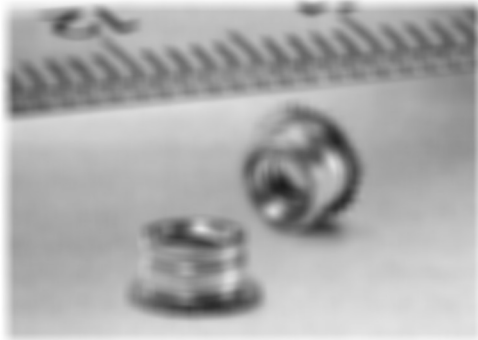


Größte Sicherheit für kleinste Teile

Die M24 Eingangsgründbuchsen aus dem Lieferprogramm der M27 Substratierung Group. Neben für Innovation und Flexibilität, um den sich stetig verändernden Anforderungen gerecht zu werden, in kleiner Bauweise und, dazu höher werden die Ansprüche an die Verbindungstechnik. Neben

Widerstandseingangsgründbuchsen M24 können nach Unternehmensanfrage alle Vorteile der Eingangsbohrer als 0,2 mm Bohrtiefe genutzt werden. Gefertigt aus vollständigem Stahl können die Eingangsbohrer sowohl in Metallbohrer als auch in andere metallische Werkstoffe leicht eingesetzt werden. Die Mündungen in Gewindegrößen von M1 und M2 sowie mit Längen von 2 und 3 mm kommen in der Elektronik, Optik, Medizin- und Kommunikationstechnik zum Einsatz.



www.m27.com

Direkt-Druck für bessere Lötqualität

„Mit dem Einsatz eines JetPrinters erhöhen wir nachhaltig die Lötqualität und die Reaktionszeit, gleichzeitig vermindern wir Nacharbeit und Kosten“, betont Michael Kuttig, Geschäftsführer der Kuttig Electronic. Dank des neuen Mydata JetPrinter MY500 ist keine Lotpastenschablone mehr erforderlich, denn



Verbesserte Lötqualität ohne Schablone

die Lotpaste wird nicht mehr aufgetragen, sondern nach dem Prinzip eines Tintenstrahldruckers mit einer feinen piezoelektrischen Düse direkt aufgedruckt. Die Lotpaste wird über Kartuschen zugeführt und unterliegt keiner Oxidation. Eine konstante Pastenqualität wird durch ein geschlossenes System erreicht. Die Pastenmenge wird individuell dosiert, auf Wunsch sogar pro Pad. Ei-

ne Korrektur der Pastenmenge kann jederzeit erfolgen. Layoutänderungen sind einfach einzupflegen. Pin in Paste und punktgenaues Auftragen von Kleber ist realisierbar. Die Verifikation des Drucks erfolgt via Kamera. Die PCB-Größen reichen von 70 mm x 50 mm bis 508 mm x 508 mm, als kleinste Bauform ist die 0201 verarbeitbar.

www.kuttig.de

Flexiblen Plattformen zur Montage

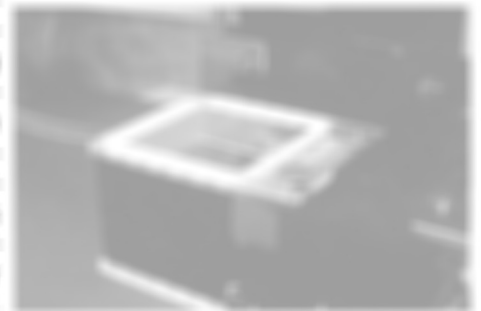


System in Positionierung für selektive Montage

H-System ist die integrierte Plattform, die eine flexible Ausführung des zu montierenden Bauteils an seiner Zielposition ermöglicht. Durch automatische Verstellungen ist es möglich, die optischen Eigenschaften von zu verändern, das ist ein weiterer die maximale Auflösung und Vergrößerung bei Bauteilen verschiedener Dimensionen zur Verfügung stellt.

Ein flexibles System für große Aufgaben – nach diesem Prinzip stellt Flexing hochwertige Geräte und Werkzeuge her, um für anspruchsvolle Anwendungen aus der Bereich der Mikroelektronik und flexible Fertigungssysteme von höchster Qualität zu werden. Für vielfältige Handhabungsaufgaben wurde das neue H-System in das Produktportfolio aufgenommen, welches durch seine kompakte Bauform, seine Integrierbarkeit für zusätzliche Module und durch die Skalierbarkeit der optischen Komponenten eine flexible Plattform für anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. dem Thermikkomponenten oder der Chipmontage darstellt. Derartige Montageprozesse erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Reproduzierbarkeit. Um die Integration in bestehende Fertigungsstrukturen zu ermöglichen, sind ein modularer Platzbedarf für geringen Anschaffungskosten verbunden mit der Erweiterung des H-Systems im Vordergrund. Aus diesen Anforderungen sind Standard System in Positionierung, welches ein Höchstmaß an Flexibilität bei geringer Aufstellfläche bietet. Diese Anwendung verfügt über Flexibilität zur Erstellung der hohen Reproduzierbarkeit sowie den nötigen Raum für anwendungsspezifische Module wie z.B. Heizen, Düsen oder kundenspezifische Bauteilplattformen, und ermöglicht es den Einsatz in der Serienfertigung im industriellen Umfeld sowie in der Forschung & Entwicklung. Ein besonderes Merkmal des

H-Systems ist die integrierte Plattform, die eine flexible Ausführung des zu montierenden Bauteils an seiner Zielposition ermöglicht. Durch automatische Verstellungen ist es möglich, die optischen Eigenschaften von zu verändern, das ist ein weiterer die maximale Auflösung und Vergrößerung bei Bauteilen verschiedener Dimensionen zur Verfügung stellt. Eine von vielen Anwendungen ist die Montage von Chips auf organischen oder anorganischen Substraten wie beispielsweise die Bauteile von WBG-Chips auf flexiblen Substratträgern. Bei diesem Prozess werden besonders kleine Bauteile auf einem im Verhältnis sehr großen Substrat montiert. Da bei einer Positionierung ein ein H-System die Bauteilpositionierung und ein ein Halbleiter erfolgt ist die Halbleiter Substratgröße gering und ermöglicht damit die kompakte Bauform für denartige Systeme. Durch den integrierten Design-er können auch kleine Mengen gefertigt werden, an der systeme Fertigung angepasst werden. Das H-System des Flexing wird über eine hochdynamische Heizeinheit gewährleistet. Die Heizeinheit ist die die Kompensations, die zur Aufrechterhaltung der Bauteil-Substrattemperatur



Das integrierte Heizelement ermöglicht exakte Montage

Automatische Selektivlötssysteme



www.ecbba.com

flexibel integriert. Zur Qualitätskontrolle der Fertigungsprozesse kann diese mittels einer Inspektionkamera verfolgt werden. Mit dem H-System ist die Balance zwischen dem Handlung von allen kleinen Bauteilen auf großen Substraten innerhalb einer kompakten Design-gehung.

www.m27.com